DERWENT-ACC-NO: 1990-331904

DERWENT-WEEK: 199044

**COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD** 

TITLE: Sheet for inserting between ceramics to be fired - comprises styrene! polymer film forming material dispersed with organic powder and polymer powder which do not fuse at the firing temp.

PATENT-ASSIGNEE: NITTO DENKO CORP [NITL]

PRIORITY-DATA:

1989JP-0061308 (March 14, 1989)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

JP 02239159 A September 21, 1990 N/A 000 N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO APPL-DATE

JP 02239159A N/A 1989JP-0061308 March 14, 1989

INT-CL (IPC): C04B035/64

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 02239159A

### **BASIC-ABSTRACT:**

The inserting sheet comprises a styrene system polymer film forming material, in which organic powder that does not fuse at the firing temps. for ceramic, and polymer powder that does not fuse on firing the ceramic, but pyrolyses, (having pyrolysing temps. at least 30 deg.C higher than that of the polymer film forming material) are dispersed.

USE - For preventing reaction between ceramic green compacts during firing, allowing separate recovery of ceramic sintered compacts easily. @(4pp DWg.No.0/0)

**DERWENT-CLASS: A97 L02** 

CPI-CODES: A04-C01; A10-E05B; A12-W12G; L02-A04;

### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-239159

®Int. Cl. 5

庁内整理番号 識別記号

→ 43公開 平成2年(1990)9月21日

C 04 B 35/64

8618-4G K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

セラミック焼成用間挿シート 50発明の名称

> 願 平1-61308 20特

頭 平1(1989)3月14日 220出

和洋 尻 田 仰発 明 者 中 司 洋 @発明者

洋 三 明者 大 石 ⑫発 誠  $\blacksquare$ 

個発 明 者 日東電工株式会社 ⑪出 顋 人

個代 理 人 弁理士 藤 本 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

L発明の名称 セラミック焼成用間挿シート 2.特許請求の範囲

1. スチレン系高分子遺膜材からなるシート中 に、セラミックの焼成温度では溶融しない無 機粉末と、セラミックの焼成時に熔触せずに 熱分解し、かつ前記スチレン系高分子造膜材 よりも30℃以上高い熱分解温度を有する高分 子系粉末を分散含有することを特徴とするセ ラミック焼成用間挿シート。

3 発明の詳細な説明

#### 産業上の利用分野

本発明は、セラミック成形体間等に介在させて 焼成時にそれらの間で反応の起こることを防止し、 焼成されたセラミック成形体を容易に個別回収す るためのセラミック焼成用間挿シートに関する。

#### 従来の技術及び課題

セラミックの焼成処理においては、セラミック 成形体同士や、セラミック成形体とその焼成台の 間などで触着して焼成体の個別回収が不能になら ないように措置する必要がある。その措置として・ アルミナやジルコニア等の無機粉末を散布する方 式では、粉塵問題や散布ムラによる焼成体の凹凸 化問題かあるため、シートを間挿する方法が検討 されている。

従来、その間挿シートとしては、無機粉末を高 分子系遺膜材中に分散含有させたものが知られて いた(特公昭60-8991号公報)。しかしながら、 焼成時にシートが収縮し、焼成体に変形や割れが 生じる問題点があった。無機粉末の含有量を増大 させて収縮を抑制する方式では、シートの脆弱化 を招き、取り扱いが困難となる。

従って本発明は、焼成時に収縮しにくく、取り 扱い性に優れるシートの開発を課題とする。

#### 課題を解決するための手段

本発明は、特殊な高分子系造膜材と、不溶融性 で可燃性の高分子系粉末を用いることにより上記 の課題を克服したものである。

すなわち、本発明は、スチレン系高分子造膜材 からなるシート中に、セラミックの焼成温度では

溶験しない無機粉末と、セラミックの焼成時に溶験せずに熱分解し、かつ前記スチレン系高分子造験材よりも30℃以上高い熱分解温度を有する高分子系粉末を分散含有することを特徴とするセラミック焼成用間挿シートを提供するものである。

作用

製性の高いスチレン系高分子造験材を用いることにより、強度の大きいセラミック焼成用間挿シートが得られ、その取り扱い性が向上して、間挿シートの製造時や加工時、さらにはセラミック成形体間等への間挿作業時に割れたり、欠けたりすることを防止することができる。

また、セラミックの焼成時に溶酸せずに熱分解し、かつ前記スチレン系高分子造腹材よりも30℃以上高い熱分解温度を有する高分子系粉末を用いることにより、無機粉末間の隙間を埋めることができて、スチレン系高分子造膜材の熱分解時に収縮しにくいシートとすることができ、焼成体の変形や割れが防止される。

発明の構成要素の例示

スチレン系重合体とスチレン系エラストマとの 組成比は、重量に基づき前者/後者で1/0.05~ 1/1が適当である。そのスチレン系エラストマ の含有組成が0.05未満では、得られるシートが柔 軟性に乏しくて破損しやすくなり、1を超えると 柔軟性が勝ちすぎてコシがなくなり取り扱い難く なる。

本発明において用いる無機粉末は、セラミック の焼成温度では溶融しないものであり、焼成時に セラミックと反応しないよう適宜に選択使用され 本発明においては、高分子系造膜材としてポリビニルブチラールやアクリル系ポリマ等の通例のポリマでは達成できない、シート強度と柔軟性を得るべくスチレン系高分子造膜材が用いられる。 用いるスチレン系高分子造膜材は、炭素と水素と酸素以外の元素を構成元素としないものが、セラミックの変性防止や、焼成炉の保全の点より好ましい。

る。一般には、アルミナ、ジルコニア、窒化アル ミニウム、窒化ケイ素、三酸化ニチタン酸バリウ ムなどからなる粉末が用いられる。

用いる無機粉末の粒度は、焼成体の触着防止や変形防止、表面の損傷防止などの点より、最大粒径300μm以下のものが好ましい。無機粉末の使用量は、スチレン系高分子造膜材100重量部あたり、5~200重量部が適当である。その使用量が5重量部を超えると得られるシートか脆くなる傾向があって好ましくない。

本発明において用いる高分子系粉末は、セラミックの焼成時に溶融せずに熱分解し、かつ併用のスチレン系高分子造膜材よりも30℃以上、就中50℃以上高い熱分解温度を有するものである。なお、その熱分解温度は、昇温速度10℃/分の条件下で熱重量分析試験した場合において重量減少率が50%となった時の温度に基づく。

一般的に用いる高分子系粉末としては、エポキ シ樹脂、ウレタン樹脂、フェノール樹脂、不飽和

3297 AVAILABLE COPY

ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、キシレン樹脂などで代表される熱硬化性樹脂からなる粉末があけられる。なお、スチレン系高分子造膜材の場合と同様、用いる高分子系粉末は、炭素と水素と酸素以外の元素を構成元素としないものが、セラミックの変性防止や、焼成炉の保全の点より好ましい。

高分子系粉末は、無機粉末間に介在して焼成時にスチレン系高分子造機材が熱分解するに、の収縮を防止、ないし抑制するもので、かいいまりその粒度は併用の無機粉末の粒度に延粉末の使用量は、無機粉末の使用量が10~2000重量部が適当である。その使用量が10重量部未満ではシートの収縮の原因となる効果に乏しく、2000重量部を超えるとそれ自体の熱分解がシート内での部分的な収縮の原因となることがあって好ましくない。

本発明の間挿シートは、スチレン系高分子遺膜 材と、無機粉末と、高分子系粉末の混合物をシート化することにより形成される。用いる各成分は、 1種であってもよいし、2種以上であってもよい。

する。無機粉末は、セラミック成形体の焼成中も 熱分解しないで残存し、スペーサとして機能して 焼成体間等の融着を防止し、焼成体の個別回収を 可能にする。

#### 発明の効果

本発明のセラミック焼成用間輝シートは、スチレン系高分子造膜材で保形したので、強度や柔軟性に優れて割れや欠けを生じにくく、取り扱い性に優れて間揮作業を効率的に行うことができる。また、熱分解温度が高い不溶性の高分子系粉末を含有させたので、前記造膜材の熱分解でシートが収縮しにくく、焼成体に変形や割れの生じることが防止される。

#### 実施例

#### 実施例1

重量平均分子量20万のポリスチレン50部(重量部、以下同じ)と、重量平均分子量が25万で、スチレン含有量が30重量%のスチレン・ブタジエン・スチレンブロック共重合体20部を含むトルエン 容液に、平均粒径が30μαのアルミナ粉末100部と

用いるシートの厚さは、焼成対象のセラミックの 種類により適宜に決定されるが、一般には50~500 畑である。セラミック間に間挿するシートが厚す ぎると、焼成体がうねるなどの変形問題を生じや すくなり、薄すぎると取り扱い難くなる。

シートの形成は例えば、キャスティング方式、 押出成形方式、ロール圧延方式など、任意な方式 で行ってよい。スチレン系高分子造膜材中に無機 粉末と高分子系粉末が均一に分散含有されるほど、 平坦性や表面平滑性に優れる焼成体の形成に有利 である。

エポキシ樹脂硬化物の粉末20部を加えて均一に混合し、その均一分散液をキャスティング法にて展開して厚さ100 mm のセラミック焼成用間挿シートを得た。

#### 実施例2

重量平均分子量20万のポリスチレン50 部と、重量平均分子量が25万で、スチレン含有量が30重量%のスチレン・ブタジエン・スチレンブロック共重合体20部を含むトルエン溶液に、平均粒径が40μ■のアルミナ粉末100部とエポキシ樹脂硬化物の粉末20部を加えて均一に混合し、その均一分散液を用いて実施例1に準じセラミック焼成用間挿シートを得た。

#### 事 旅 例 3

重量平均分子量20万のポリスチレン100部と、 重量平均分子量が25万で、スチレン含有量が25重量%のスチレン・イソプレン・スチレンブロック 共重合体50部を含むトルエン路液に、平均粒径が

# BEST AVAILABLE C.

-365-

30μmのアルミナ粉末100部とフェノール樹脂硬化物の粉末50部を加えて均一に混合し、その均一分散液を用いて実施例1に準じセラミック焼成用間輝シートを得た。

#### 比較例1

重量平均分子量 5 万のポリビニルブチラール50 部を含む酢酸エチル溶液に、平均粒径30 mのアルミナ粉末100 部を加えて均一に混合し、その均一分散液を用いて実施例 1 に準じセラミック焼成用間挿シートを得た。

#### 比較例2

ポリビニルブチラールの使用量を200部とした ほかは比較例1に準じてセラミック焼成用間挿シ ートを得た。

#### 評価試験

実施例、比較例で得たセラミック焼成用間挿シートを15cm角に接断し、これを15cm角で厚さ0.8mmのアルミナグリーンシート6枚の積み重ね体に

おける層間及び最下部に間挿して焼成した。

前記の処理において、シートの取り扱い性(魔さ)、焼成中及び焼成後におけるアルミナグリーンシートの割れ、得られた焼成体の平坦性や表面の平滑性を調べた。

結果を表に示した。

		実 施 例			比较例	
		1	2	3	. 1	2
取り扱い性		良好	良好	良好	破断	良好
割	烧成中	無	無	無	有	有
ħ	焼成後	無	無	無	有	有
烧成	平坦性	良好	良好	良好	うねる	うねる
体	平滑性	良好	良好	良好	-	

特許出願人 日東電工株式会社 代 選 人 藤 本 勉

## BEST AVAILABLE